

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-042

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

《晶方科技 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于对外投资进展及增加投资额度的议案》

根据马来西亚子公司 WaferTek Solutions Sdn Bhd 建设规划及发展需求，公司拟以自有资金向马来西亚子公司增加 3,000 万美元的投资额度，其投资金额由 5,000 万美元增加至 8,000 万美元。

《晶方科技关于对外投资进展以及增加投资额度的公告》（公告编号：临 2024-044）详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年10月30日